

Judul:

3D IC stacking technology

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Three-dimensional integrated circuits ; Microelectronic packaging

Nomor Panggil:

621.381 53 THR

Penerbitan:

McGraw-Hill

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)